





# Eric ROULAND, **AREELIS Technologies**Moncef KADI, **IRSEEM ESIGELEC**

#### **DiThAA**

Dissipation Thermique des Antennes Actives











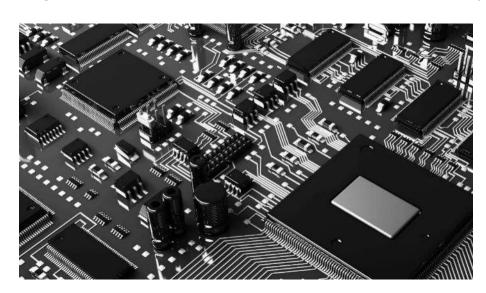




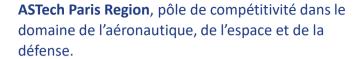
*Initiative* 

#### Le Centre Français de Fiabilité

Regroupement d'experts de la fiabilité des systèmes et des composants électroniques









NAE (Normandie AeroEspace), la filière d'excellence en Normandie dans l'aéronautique, le spatial, la défense et la sécurité.



Pôle de compétitivité européen. **NextMove** rassemble en Normandie et Île-de-France, la « Mobility valley » française, toutes les énergies de l'écosystème Automobile et Mobilités.

Les Rendez-Vous Fiabilité du CFF sont un évènement mensuel, organisé en visioconférence sur des travaux en lien avec les thématiques du CFF.

Cette année, nous vous proposons de profiter de ce temps d'échanges pour vous présenter les compétences au sein de la communauté CFF, et de donner « carte blanche » à un membre pour présenter des travaux, des projets, des résultats et des perspectives, sur un sujet particulier en lien avec la Fiabilité des Composants et Systèmes Electroniques.















Modalités

#### Format de la webconférence :

La webconférence se déroule via l'outil de conférence Cisco WebEx

La webconférence dure 60 minutes. de 13h00 à 14h00.

Une séance de Questions / Réponses se tiendra durant 10 mn à l'issue de l'intervention.

#### Règles de fonctionnement de la webconférence :

Pour l'intervenant : il aura le rôle de présentateur pour afficher son support de présentation.

Dans la mesure du possible, il allumera sa webcam durant son exposé.

Pour les auditeurs : vos micros seront coupés durant la webconférence.

Vous pourrez poser vos questions par le chat de l'application durant l'exposé.

Il n'y a pas de nécessité de connecter sa webcam.

Pour des soucis de qualité, nous vous conseillons de vous munir d'un système audio adapté.

#### Et après :

Les présentations seront mises à disposition via un lien de téléchargement sur le site du CFF. Il n'y aura pas de replay pour des raisons de confidentialités de certains éléments échangés.















#### Expertises de l'intervenant

**CFF** 

Mettre en aras le ou les champs concernés



**Structure: AREELIS Technologies** 

675 Avenue Isaac Newton, Adresse:

76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

eric.rouland@areelis.com Contact:



Académique

**Industriel** 

Cluster

Société savante



Modélisation et simulation



**Expérimental** 



Cycle de vie

#### Notre spécialisation:

AREELIS Technologies développe et réalise intégralement (du bureau d'études aux essais de validation/qualification) des systèmes de refroidissement sur mesure, innovants et adaptés aux applications électriques et électroniques (batteries, modules et cartes électroniques, moteurs électriques).

#### Notre mission:

Accompagner nos clients pour l'innovation dans le transport











#### Thématiques:





Fiabilité des systèmes mécatroniques

#### **Expertises:**

Connaissances et moyens d'investigations sur les matériaux « électriques » et les composants

Ingénierie de l'environnement (mécanique, climatique et Compatibilité électromagnétique [CEM])

#### Management thermique

DataScience, Statistique et IA

(顱) Analyse de construction

到 Analyse de défaillance

#### Participez vous à des groupes de normalisation ?

✓ Non





















#### Expertises de l'intervenant

**CFF** 

Mettre en aras le ou les champs concernés



Structure: IRSEEM/ESIGELEC

Adresse: Avenue Galilée.

76800 Saint Etienne du Rouvrav

Contact: moncef.kadi@esigelec.fr **Type** 

Académique

Industriel Cluster

Société savante



**Expérimental** 

**Domaines** 



Cycle de vie

L'IRSEEM (Institut de Recherche en Systèmes Electroniques Embarqués) est le laboratoire de recherche de l'ESIGELEC, école d'ingénieur située à Saint Etienne du Rouvray dans le sud de Rouen. Au sein de son pôle électronique et systèmes, il développe une forte expertise dans les domaines de la CEM et la fiabilité des composants et systèmes électroniques.

L'IRSEEM a participé à de nombreux projets structurants en région et au niveau national (FUI) autour de la thématique de la fiabilité des systèmes mécatroniques de puissance.

#### Thématiques:



Fiabilité des composants électroniques de puissance et leur packaging



Fiabilité des technologies liées à la connectique et à l'assemblage (connectiques, PCB, Busbars...)



Fiabilité des systèmes mécatroniques

#### **Expertises:**



Connaissances et moyens d'investigations sur les matériaux « électriques » et les composants



Ingénierie de l'environnement (mécanique, climatique et Compatibilité électromagnétique [CEM])



Management thermique



DataScience, Statistique et IA



( Analyse de construction



到 Analyse de défaillance





























# Eric ROULAND, AREELIS Technologies Moncef KADI, IRSEEM ESIGELEC

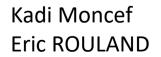
**DiThAA** 

Dissipation Thermique des Antennes Actives



















Sommaire

- Contexte et enjeux du projet
- II. Présentation des systèmes SAFRAN et NXP
- III. Présentation de la solution TE Présentation des expérimentations réalisées Synthèse, conclusions et perspectives
- IV. Présentation de la solution MCP Présentation des expérimentations réalisées Synthèse, conclusions et perspectives













Sommaire

Contexte et enjeux du projet













#### Contexte et enjeux du projet

**Di**ssipation **Th**ermique des **A**ntennes **A**ctives – DiThAA Projet :

Lieu : Normandie

07/01/2020 au 30/06/2022 Période :

Budget : 1,9M€

Subvention: 1,0M€





#### Description :

- Etudier la faisabilité de solutions de dissipation thermique permettant l'utilisation des antennes actives dans les conditions d'environnement pour deux applications :
  - la communication 5G avec NXP
  - l'internet à bord d'un avion civil (In Flight Connectivity)

















Sommaire

## II. Présentation des systèmes SAFRAN et NXP









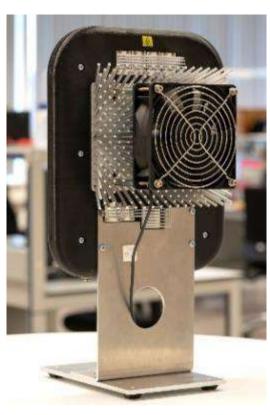




#### Présentation des systèmes SAFRAN et NXP

Antenne 5G (NXP)







➡ Antenne internet à bord d'un avion (SAFRAN)









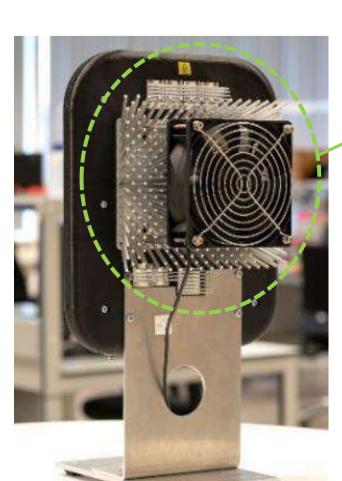












#### Objectifs 5G:

Diminuer le volume d'intégration de 75% la solution tout en gardant les mêmes performances de la liaison radio (système d'antennes + frontend IC)

#### Profil de mission :

- Fusion de l'émission / réception sur la même antenne
- ⇒ 15 ans de durée de vie // Fonctionnement 24h/24h
- Tx : 90% Rx : 10% entre 24GHz et 28GHz
- EIRP: 55dBmi pour un réseau de 64 éléments
- **33W à dissiper** pour un réseau de 64 éléments
- Température opérationnelle du système de -40°C à +55°C (température ambiante)
- Tmax composant (capot) = 105°C // Technologie composant: SiGe







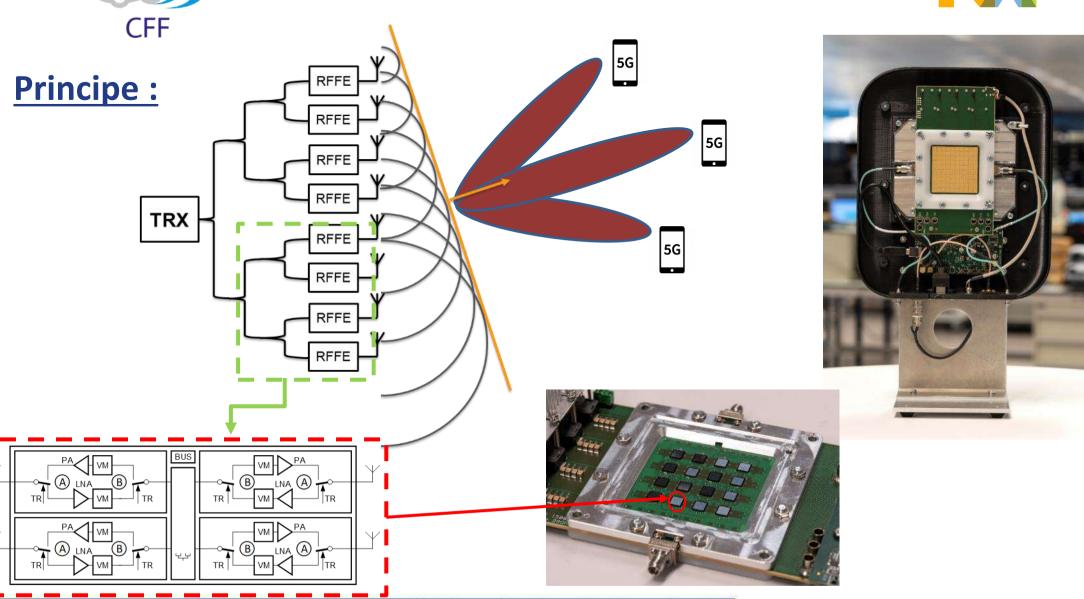






Antenne









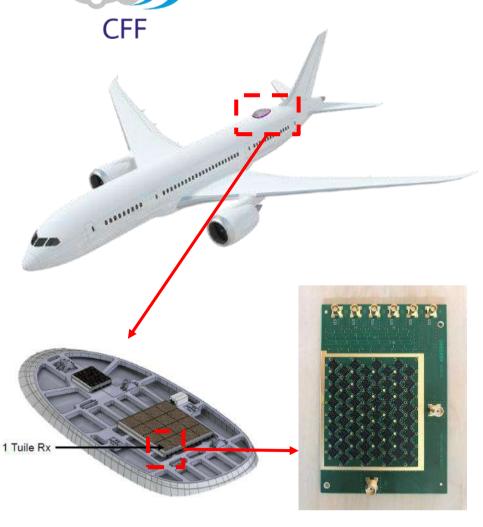












Antenne composée de 16 tuiles

1 Tuile comporte 64 éléments dissipateurs

#### Objectifs:

- Développement d'une antenne à balayage électronique (orientation du faisceau électroniquement) pour être intégrée sur un avion commercial.
- Cette antenne est équipée d'une antenne émission (Tx) et d'une antenne réception (Rx)
- L'étude sera réalisée sur la partie Rx plus énergivore.
- Chaque antenne est composée de 16 tuiles
- Chaque tuile comporte 64 éléments dissipateurs.
- L'étude portera sur une seule tuile.
- Puissance à dissiper par tuile = 20W











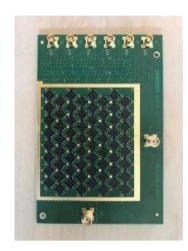






#### **Principe:**

- Améliorer de 30% la dissipation thermique des antennes actives.
- ➡ Viser une épaisseur du système de refroidissement placé sous les éléments rayonnants la plus faible possible.
- Améliorer l'efficacité de la dissipation thermique tout en améliorant la fiabilité et la durée de vie
- Tester la compatibilité des solutions proposées aux certifications aéronautiques.















Sommaire

## III. Présentation de la solution TE et des expérimentations réalisées

- Présentation laboratoire IRSFFM de l'ESIGFLEC
- Solution de refroidissement par Thermo-Electricité (TE)
- **Antenne active NXP** 3.
  - Dispositif de refroidissement NXP
  - Résultats des essais NXP
- **Antenne active SAFRAN** 4.
  - Dispositif de refroidissement SAFRAN
  - **Fssais SAFRAN**
- **5**. **Conclusion du projet**















Pôle Electronique et Systèmes

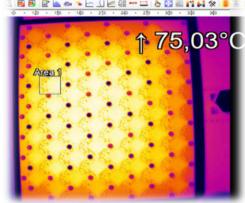






- **Electronique**
- Hyperfréquences
- **CFM**
- Fiabilité des composants et des systèmes
- Compétences spécifiques mises en jeu
  - Modélisation Electrothermique
  - Conception et fabrication mécanique
  - Instrumentation et caractérisation thermique
  - Caractérisation RF



















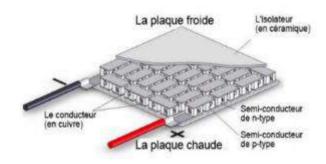




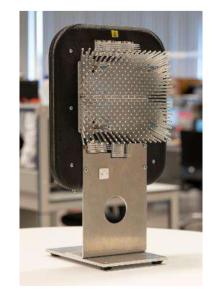


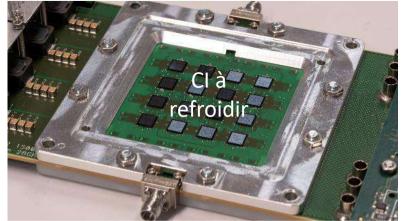


- ➡ Antenne 5G composée d'un panneau de 64 patchs;
- Chaque 4 antennes patch sont pilotés par un circuit intégré Tx/Rx;
- Remplacer le refroidisseur actuel pour réduire son encombrement de 75%.
- → Tester la faisabilité de la thermoélectricité comme solution alternative



























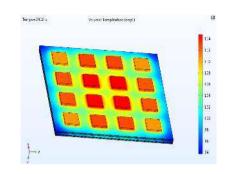


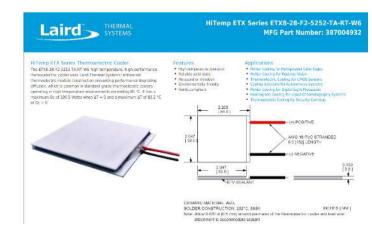


#### → Différentes étapes avant d'arriver à une solution :

- Etude théorique et par simulation électrothermique du module NxP (LIV2 de l'ESIGELEC);
- Etude du cahier de charge (Temp max, dimensions, puissance à dissiper, ...);
- Choix d'un module TE adapté;
- Conception et fabrication d'une solution de refroidissement basée sur l'utilisation de ce module TE;
- Validation de la solution par simulations numériques;
- Implémentation de la solution sur le panneau et tests de validation.

Les Rendez-Vous Fiabilité du CFF - 13 décembre 2022



















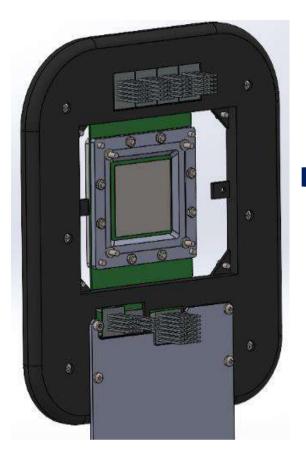


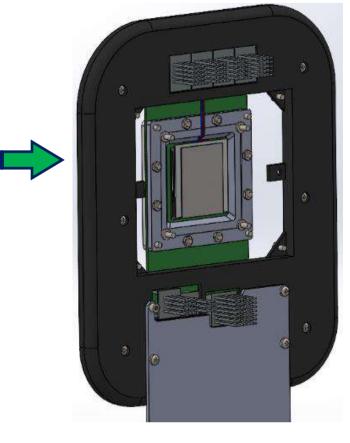


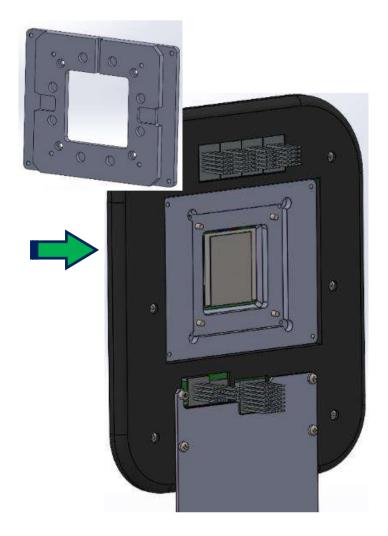




#### → Détails de la solution proposée :







TIM

TIM recouvrant le module Peltier

Plaque de fixation



















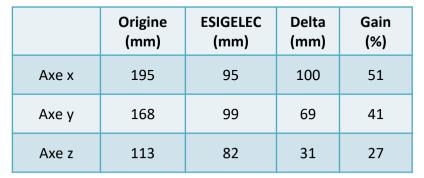




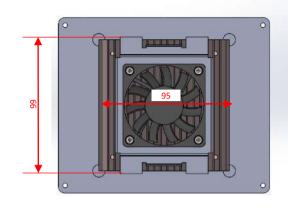
#### → Détails de la solution proposée :

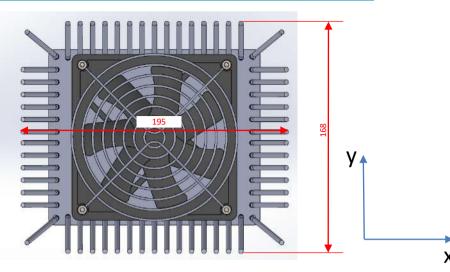


Rajout d'un dissipateur et d'un ventilateur



	Origine	ESIGELEC	Delta	Gain
	(dm³)	(dm³)	(dm³)	(%)
Volume	3,70	0,87	2,83	69



















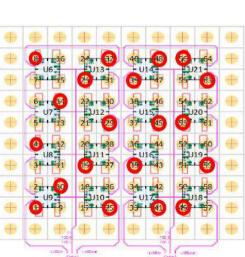








#### Température avec système originel de refroidissement



	Antenne	CI	Temperature (°C), P <sub>in</sub> = -4 dBm					
			24.25 GHz		25.875 GHz		27.5 GHz	
			Pol	Pol	Pol	Pol	Pol	Pol
			verticale	horizontale	verticale	horizontale	verticale	horizontale
	1	[3,1] / U9	34	36	35	36	35	36
	4	[2,1] / U8	36	35	36	35	36	35
	8	[0,1] / U6	34	33	34	34	35	34
	10	[3,1] / U9	34	35	34	35	34	36
	14	[1,1] / U7	33	33	3	35	34	35
	19	[2,0] / U11	33	35	34	35	34	36
•	23	[0,0] / U13	34	35	34	36	35	36
	25	[3,0] / U10	35	34	36	35	36	35
•	29	[1,0] / U12	34	34	35	34	36	35
	32	[0,0] / U13	34	36	35	37	35	37
	35	[2,3] / U16	35	35	37	35	37	36
	39	[0,3] / U14	35	34	36	35	36	35
	41	[3,3] / U17	35	36	36	37	36	37
	45	[1,3] / U15	34	36	35	36	35	37
	48	[0,3] / U14	34	33	35	34	35	34
	49	[3,2] / U18	35	34	36	35	36	35
	53	[1,2] / U20	36	35	37	36	37	36
	56	[0,2] / U21	36	37	37	38	37	38
	59	[2,2] / U19	34	35	35	36	35	37
	63	[0,2] / U21	35	36	36	37	36	38













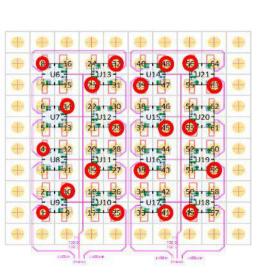








#### → Température avec système de refroidissement ESIGELEC



Antenne	CI	Température (°C), P <sub>in</sub> = -4 dBm					
		24.25 GHz		25.875 GHz		27.5 GHz	
		Pol	Pol	Pol	Pol	Pol	Pol
		Verticale	horizontale	verticale	horizontale	verticale	horizontale
1	[3,1] / U9	22	22	22	22	23	22
4	[2,1] / U8	22	20	22	20	22	21
8	[0,1] / U6	23	20	23	21	23	21
10	[3,1] / U9	21	22	21	22	22	22
14	[1,1] / U7	19	20	19	21	20	21
19	[2,0] / U11	18	19	17	19	18	19
23	[0,0] / U13	20	21	20	21	20	21
25	[3,0] / U10	23	21	23	21	23	21
29	[1,0] / U12	20	18	20	18	20	18
32	[0,0] / U13	21	22	21	22	21	22
35	[2,3] / U16	20	18	20	19	20	18
39	[0,3] / U14	21	20	21	20	21	20
41	[3,3] / U17	21	23	22	23	22	23
45	[1,3] / U15	19	21	19	21	20	21
48	[0,3] / U14	21	19	21	19	21	19
49	[3,2] / U18	24	23	24	23	24	23
2353	[1,2] / U20	22	21	22	21	22	21
56	[0,2] / U21	21	23	21	23	22	23
59	[2,2] / U19	20	22	20	22	22	22
63	[0,2] / U21	20	23	20	22	21	23















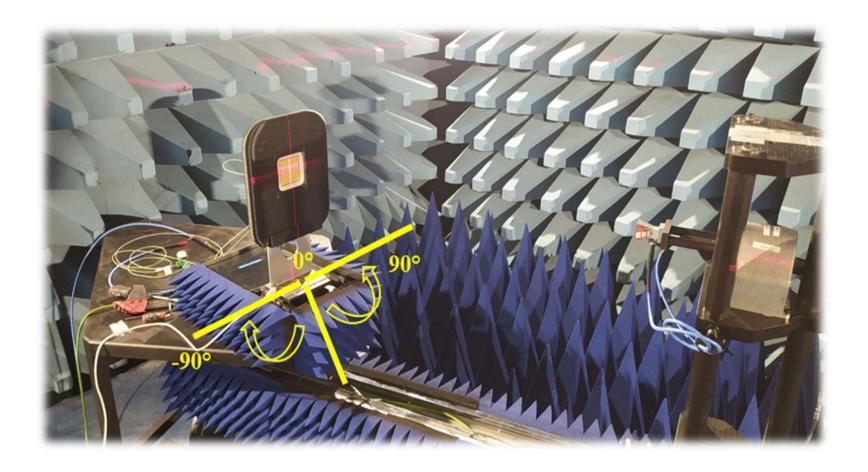








#### → Mesure RF et comparaison des performances

















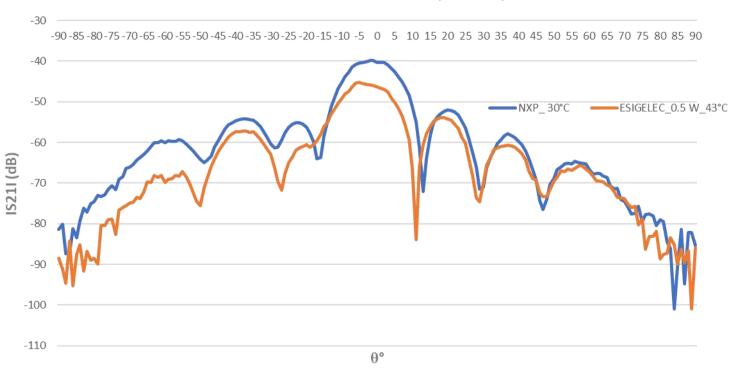






#### → Mesure RF avec système NxP et système ESIGELEC





- Polarisation verticale: 6dB d'écart au max entre la solution NxP et la solution ESIGELEC!
- Est-ce que c'est dû au profil de la température?























#### Livraison d'une preuve de concept d'un système de refroidissement adapté à l'antenne NxP:

- Example 1 Page 1 Page
  - Facilité de montage
  - Température de la surface inférieure à 90°C même quand toutes les puces sont activées au même temps
  - Possibilité de piloter le module Peltier
- Maintien des performance RF : légère baisse le cas du beam forming à 0° → à investiguer pour d'autres scénarios















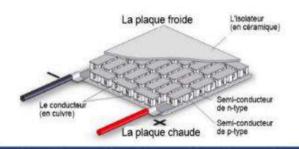




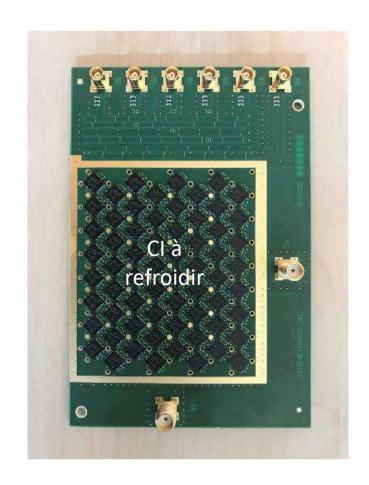




- Carte d'antennes actives proposée pour l'internet à bord composée de 64 antennes;
- Chaque antenne patch est pilotée par un circuit intégré Tx/Rx;
- Proposer un refroidisseur avec une hauteur inférieure à 80mm fonctionnant entre -40° et +55°;
- → Tester la faisabilité de la thermoélectricité comme solution de refroidissement



Les Rendez-Vous Fiabilité du CFF - 13 décembre 2022

















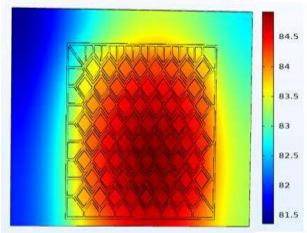


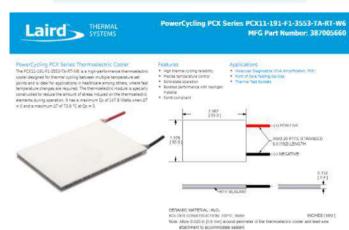




#### → Différentes étapes avant d'arriver à une solution :

- Etude du cahier de charge (Temp max, dimensions, puissance à dissiper, ...);
- Choix d'un module TE adapté;
- Conception et fabrication d'une solution de refroidissement basée sur l'utilisation de ce module TE;
- ➡ Validation de la solution par simulations numériques;
- Implémentation de la solution sur le panneau et tests de validation.

















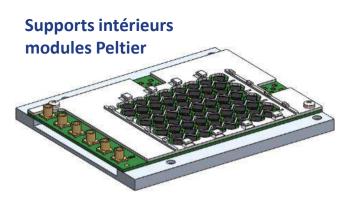


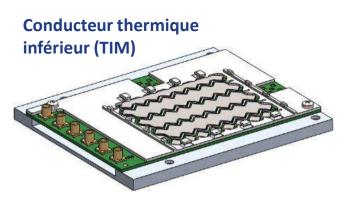


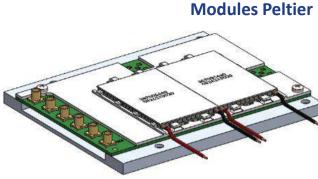




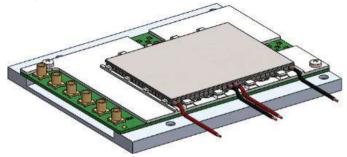
#### → Détail de la solution proposée :

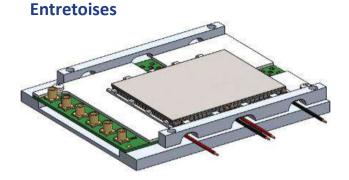


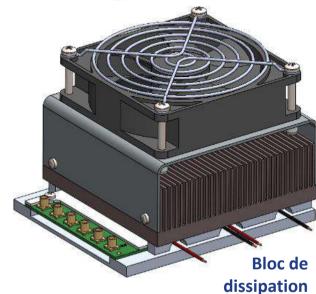


























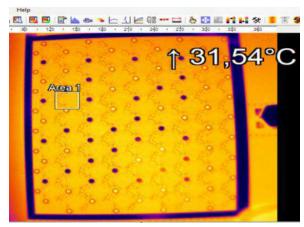




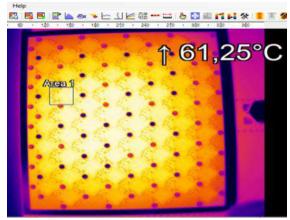




#### Température sans système de refroidissement



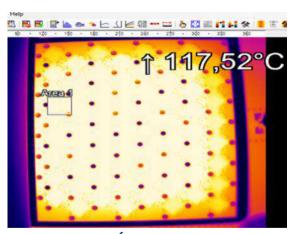
Étape 1



Étape 6



Étape 10 après dix minutes



Étape 10

















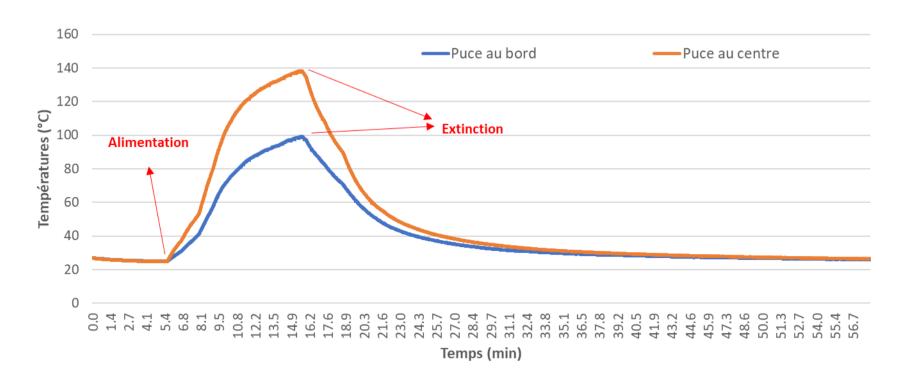






#### Température sans système de refroidissement avec thermocouples

Caractérisation de la carte SAFRAN à vide à  $T_{amb}$  = 25°C













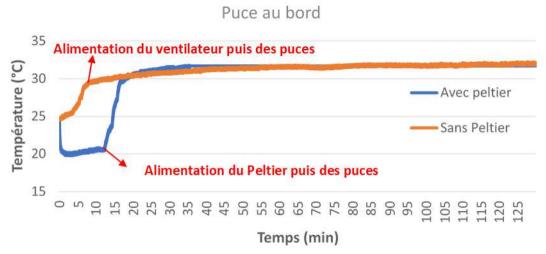




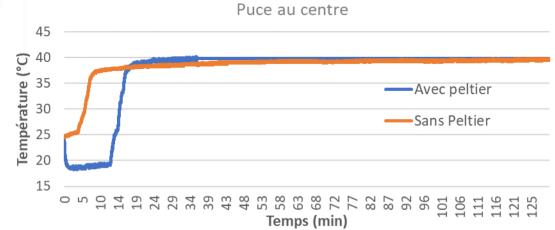




#### Température avec système de refroidissement à 25°C



Couple du Peltier  $(U_1, I_1) = (1.6 \text{ V}, 1 \text{ A})$ 















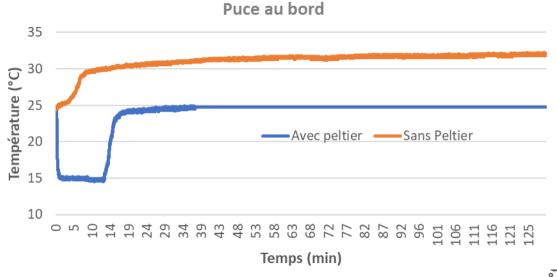




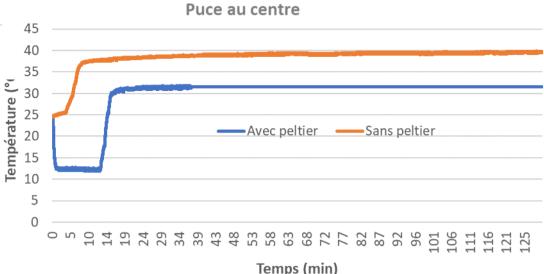




#### Température avec système de refroidissement à 25°C



Couple du Peltier  $(U_1, I_1) = (3.1 \text{ V}, 2 \text{ A})$ 















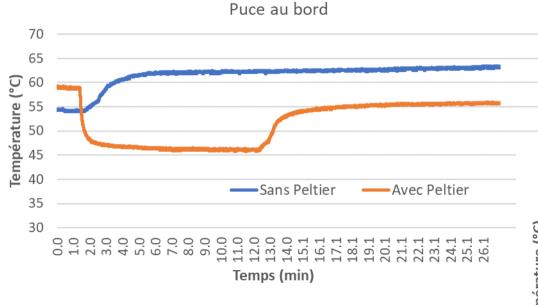






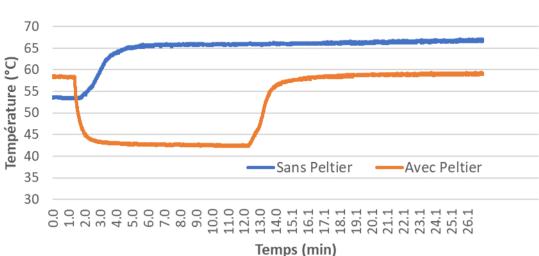


#### Température avec système de refroidissement à 55°C



Couple du Peltier  $(U_1, I_1) = (3.6 \text{ V}, 2 \text{ A})$ 

Puce au centre

















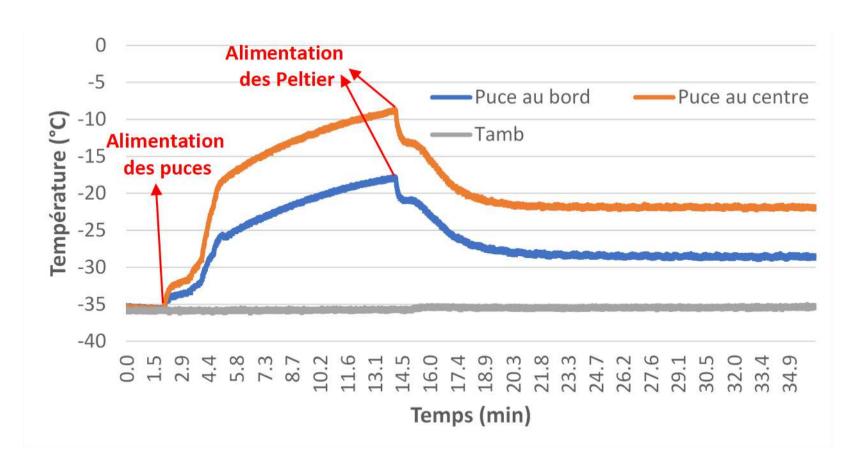








#### Température avec système de refroidissement à -40°C















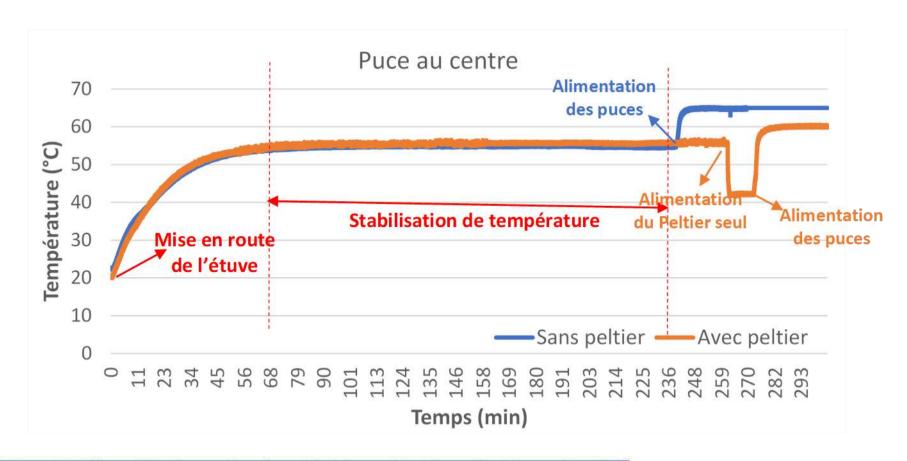








#### → Stabilité du module lors de variation de température

























## → Conclusions

## Livraison d'une preuve de concept d'un système de refroidissement adapté à l'antenne SAFRAN

- > Hauteur de 7,5cm → possibilité de réduire la hauteur du dissipateur qui est surdimensionné pour la sécurité des essais:
  - Facilité de montage:
  - Température de la surface entre 7 et 60° selon la température ambiante ;
  - Possibilité de piloter l'alimentation du Peltier;
  - ▶ Validation du fonctionnement à 25°C, 55°C et -40°C.
- Le module TE nécessite une solution de convection forcée (ventilateur) pour évacuer les calories sur la face chaude. Cela introduit un système supplémentaire, et une source de défaillance à prendre ne compte dans la maintenance (MTBF), ce qui est un handicap pour cette solution.

















Sommaire

# IV. Présentation de la solution MCP et des expérimentations réalisées

- 1. Présentation AREELIS Technologies
- 2. Solution de refroidissement par MCP
- 3. Antenne active NXP
  - 1) Dispositif de refroidissement NXP
  - 2) Résultats des essais NXP
- 4. Antenne active SAFRAN
  - Dispositif de refroidissement SAFRAN
  - 2) Essais SAFRAN
- 5. Conclusion du projet















# **AREELIS Technologies**

- Spécialiste de solution thermique pour systèmes embarqués
- > Concepteur de banc d'essais
- Centre d'essais





















Quelques références :









**VEOLIA** 



**AIRBUS** 













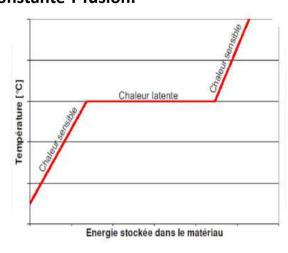






# Solution de refroidissement par MCP

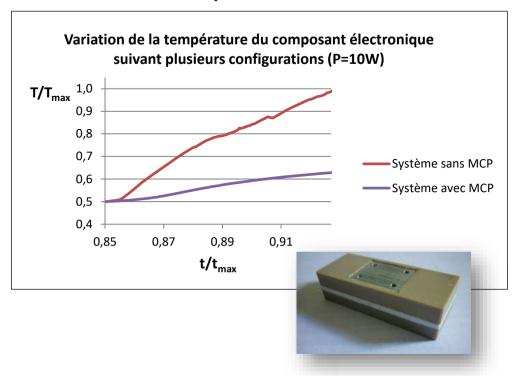
Le MCP est un composé qui absorbe et libère la chaleur lors d'une transformation à changement de phase à température constante T fusion.





Exemples de MCP (paraffines, sucres, sels,...)

## Principe de fonctionnement



## **Avantages:**

- Solution passive
- Dissipation thermique importante associée à une structure thermodiffusante
- Isolation thermique vis-à-vis de l'environnement extérieur
- Encombrement réduit dans le volume disponible
- Maintenance facile

# Inconvénients Pas de manage

- Pas de management thermique
- ■Utilisable sur profil cyclé
- Inertie thermique du MCP à prendre en compte







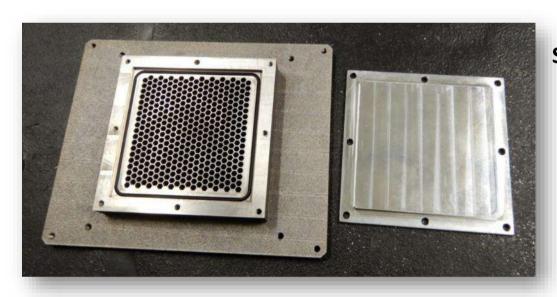








## Dispositif de refroidissement NXP



## Structure dissipatrice: ARE-0620-01-P01-001

■ Type : Structure en nid d'abeilles

■ Matériau : Alliage d'aluminium

■ Dimensions: 90x90x12 mm

■ Procédé de fabrication : Fabrication

additive

■ Nombre d'alvéoles : 399

■Ø: 3,2 mm h: 12 mm e: 0,2 mm



MCP: ARE-0620-01-P01-009

Kerafine 95: Paraffines

oTempérature de fusion : +95 ∘C

oChaleur latente: 260 kj/kg

oChaleur spécifique : 2,20 kj/kg.∘K oMasse volumique: 900 kg.m<sup>-3</sup>







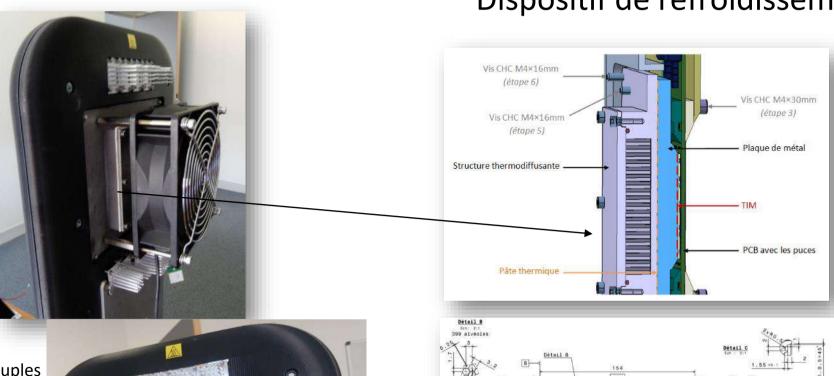




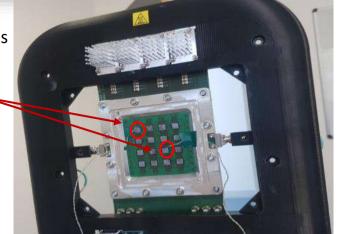


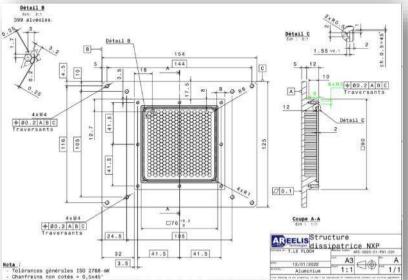


Dispositif de refroidissement NXP



Via Thermocouples type K classe 2











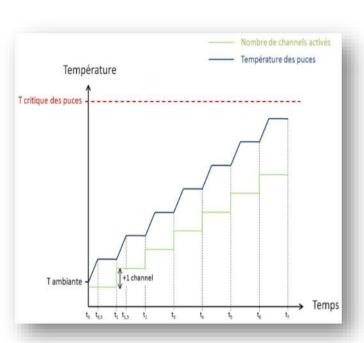


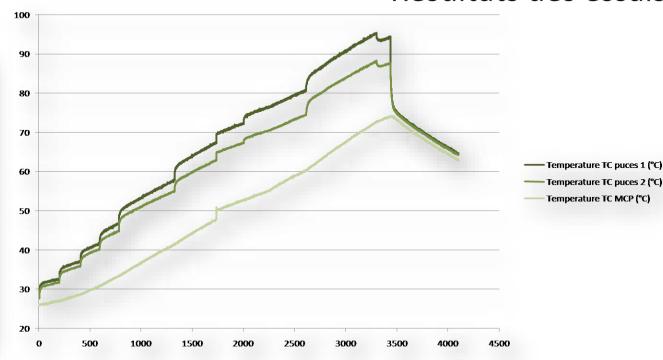






## Résultats des essais





#### Procédure:

•Antenne : Mode T<sub>X</sub>

•Activation d'un channel supplémentaire toutes les 5 min ├

- Module MCP
- $\bullet$ Tamb = 15°C

#### Conclusion n°1:

- Refroidissement non efficace
- Absence du palier de changement de phase
- + Système étanche







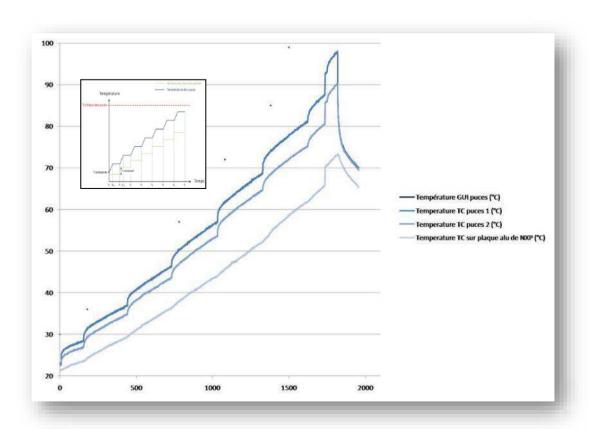


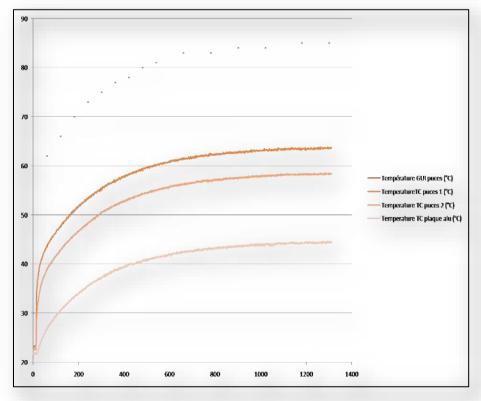






## Résultats des essais





#### Procédure:

•Antenne : Mode T<sub>x</sub>

•Activation d'un channel supplémentaire toutes les 5 min ou activation de tous les channels

Sans module MCP

 $\bullet$ Tamb = 18°C

•Tlim: 115°C

#### Conclusion n°2:

-  $T_{plaque} < T_{fusion}$ 

-/+ Dissispation par conduction efficace

=> Modifier le MCP : ARE-0620-01-P02-011 Kerafine 60-62







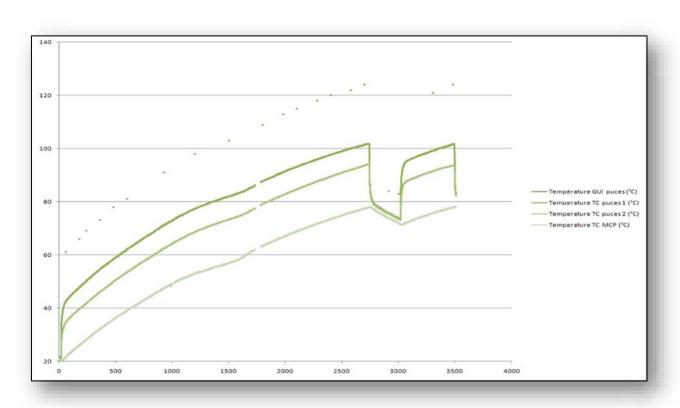








## Résultats des essais



#### Procédure:

•Antenne : Mode T<sub>x</sub>

Activation de tous les channels

Avec module MCP: ARE-0620-01-P02-011

Kerafine 60-62

 $\bullet$ Tamb = 18°C

•Tlim: 115°C

## Conclusion n°3:

- Refroidissement non efficace
- -/+ palier de changement de phase
- « potentiellement » présent
- Chaleur latente insuffisante
- + Système étanche













Dispositif de refroidissement SAFRAN



■ Type : Structure en nid d'abeilles

■ Matériau : Alliage d'aluminium

■ Dimensions 75x70x3,5 mm

Procédé de fabrication : Fabrication additive

■ Nombre d'alvéoles : 333

■Ø: 3,2 mm h: 8 mm e: 0,2 mm



Les Rendez-Vous Fiabilité du CFF - 13 décembre 2022

MCP: ARE-0620-01-P02-011

■Kerafine 60-62: Paraffines

oTempérature de fusion : +60.5 °C

oChaleur latente: 205 kj/kg

oChaleur spécifique : 2,20 kj/kg.∘K









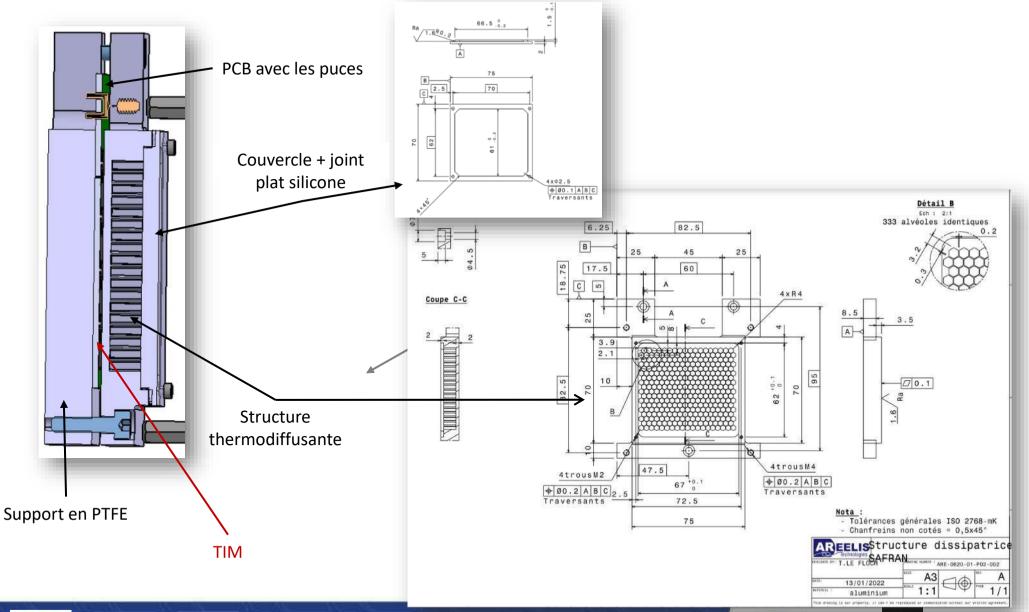








Dispositif de refroidissement SAFRAN









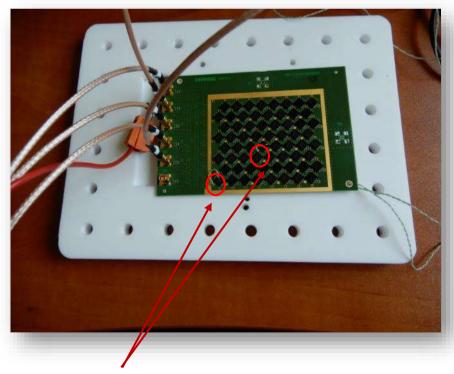




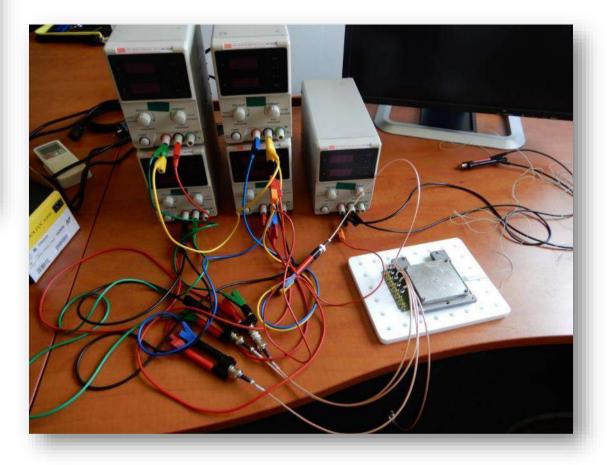




Dispositif de refroidissement SAFRAN



Thermocouples type K









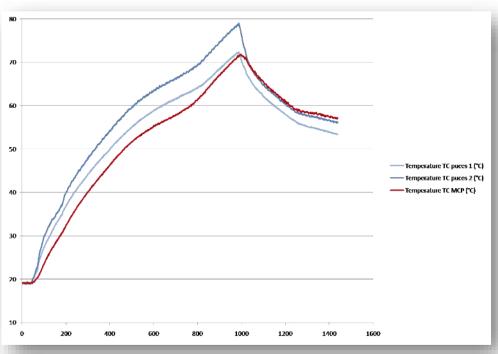


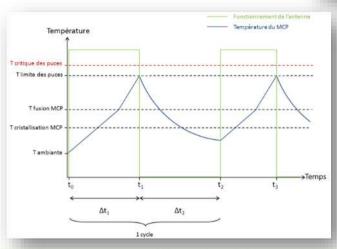






## Résultats des essais





## Procédure:

- Module MCP
- •Tamb = 17°C

#### Conclusion n°1:

- Refroidissement non efficace
- Appui non homogène sur le pad (fig 1)
- -/+ palier de changement de phase
- « potentiellement » présent
- Chaleur latente insuffisante
- + Système étanche















# **Conclusion**

## **□** Deux Objectifs :

- Obj n°1: Preuve de concept « changement de phase » adaptée aux systèmes antennaire
- Obj n°2 : Evaluation de l'efficacité et de la fiabilité du démonstrateur

#### ☐ Résultats attendus

Disposer d'une solution de dissipation thermique permettant le fonctionnement optimal d'une antenne 5G avec pour enjeu :

- 1. Avoir un faible coût énergétique
- 2. Diminuer le volume d'intégration de 75% d'une solution de dissipation thermique pour des antennes actives pour la communication 5G (démonstrateur NXP) tout en gardant les mêmes performances de la liaison radio
- 3. Minimiser l'épaisseur du dispositif de refroidissement (ordre du centimètre) ainsi que la surface d'échange tout en gardant les mêmes performances

#### Bilan

- Une solution de dissipation thermique a été développée pour chaque type d'antenne en intégrant le développement de la méthodologie de fabrication et d'intégration sur antenne.
  - ⇒ Chaque solution répond bien aux 3 exigences attendues.
- Les solutions développées ne permettent pas d'assurer une fiabilité thermique des antennes
  - ⇒ Choix du MCP (paraffine) inadapté : incompatibilité temporelle, Niveau de puissance thermique à dissiper et niveau de température.
- Grace au projet DITHAA la société a renforcé ses compétences et expertises sur l'exploitation des MCP
  - ⇒ Sectorisation des applications



















Eric ROULAND, **AREELIS Technologies**Moncef KADI, **IRSEEM ESIGELEC** 

**DiThAA** 

Dissipation Thermique des Antennes Actives

















# National Reliability Technology Workshop

16 mars 2023

Sujet : La température dans la fiabilité des systèmes et des composants électroniques Subject: Temperature in the reliability of electronic systems and components

# AGENDA: 16 mars 2023 Campus du Madrillet Rouen

En présentiel Format:

- Exposés Contenu:

- Tables rondes

- RdV BtoB

- Visite de labo

Inscription: **Prochainement** 

Tarif: **Prochainement** 

Seul l'orateur principal est libre de frais de participation.

#### 900 Introduction

Présentation des techniques et moyens de mesure de la 9.30 température lors d'essais multiphysiques (climatique, radiation, vibrations, humidité, ...)

- Electriques, Cristaux liquides, Infra-rouge, Raman, SThM, Thermo-réflectance, AFM, ...
- Quels progrès en 20 ans [2000 2020] ?
- Ouelles tendances sur les futurs movens de mesure ?
- Table ronde

Pause déjeuner + Rendez-vous BtoB + Visite du GPM 12.00

14.00 Quelles mesures de T° pour quel type de besoins industriels? Panel de cas d'étude

- Ti et ... Validation de nouvelles technologies de composants
- Ti et ... Sûreté de fonctionnement des systèmes (maintenance)
- Ti et ... Design des composants Retour d'expérience
- Ti et ... Fiabilité dans l'industrie
- Ouels sont les Paramètre électrique thermo Sensible (PETS) ?
- Quels impacts sur la fiabilité, la réparabilité, la maintenance ?

Conclusion 17.30















Agenda

L'agenda est susceptible d'être modifié. Voir agenda NAE pour confirmation. Lien

Date du webinar 2 <sup>e</sup> mardi du mois		Sujet	Inscription
mardi 11 octobre 2022	LEM3 LABORATORE DETUDE DES MICHOGRAUCTURES CES. MITERIALE	Caractérisation thermo-mécanique des matériaux et des interfaces, en vue de prédire la fiabilité des Circuits imprimés	<u>Lien</u>
mardi 13 décembre 2022	IRSEEM ESIGELEC AREELIS Technologies ESIGELECT IRSEEM ESIGELECT AREELIS Technologies	DiThAA (Dissipation Thermique des Antennes Actives) - Communication 5G, avec NXP - Internet à bord d'un avion civil, avec SAFRAN Data Systems Solutions technologiques : - Matériaux à changement de phase - AREELIS Technologies - Module Peltier (Thermoélectricité) - IRSEEM - ESIGELEC	<u>Lien</u>
mardi 14 février 2023	CEA Tech	Caractérisation des éléments parasites de composants grand gap et de leur packaging en utilisant des méthodes issues de la RF. Perspectives sur l'impact de la fiabilité des interrupteurs de puissance.	<u>Lien</u>
mardi 11 avril 2023	Intervenant	Sujet à identifier	
mardi 13 juin 2023	Intervenant	Sujet à identifier	















Contacts CFF: cff@nae.fr

Samuel CUTULLIC François BOUVRY



Geoffroy MARTIN
Pierre DE BOUCAUD



Severine COUPE



Notre site internet : Notre compte LinkedIn : <u>Centre-français-fiabilite</u> <u>Centre-français-fiabilite</u>











